

Servidores Dell PowerEdge en rack

DELLTechnologies

Guía de referencia rápida

Los servidores en rack Dell PowerEdge lo ayudan a crear una infraestructura moderna que minimiza los retos de TI e impulsa el éxito del negocio. Nuestra guía de referencia rápida (QRG) incluye una vista condensada de todo nuestro portafolio de servidor en rack.

Servidor en rack	R470	R570	R670	R770	R770AP	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd
										
Atributos clave	Especialmente diseñados para maximizar la eficiencia y la asequibilidad con servidores optimizados de un solo conector que ofrecen un rendimiento potente para microservicios web y de aplicaciones a escala de nube, servicios de datos, virtualización y base de datos de escalamiento horizontal.	Especialmente diseñados para maximizar la eficiencia y la asequibilidad con servidores optimizados de un solo conector que ofrecen un rendimiento potente para microservicios web y de aplicaciones a escala de nube, servicios de datos, virtualización y base de datos de escalamiento horizontal.	Ecosistema abierto optimizado para cargas de trabajo de computación y diseñado a fin de optimizar la potencia y equilibrar el rendimiento en implementaciones de alta densidad, aplicaciones nativas en la nube y SDS todo flash.	Ecosistema abierto optimizado para cargas de trabajo de computación y que proporciona el máximo rendimiento con potencia optimizada en virtualización y microservicios, aplicaciones nativas en la nube y análisis a gran escala.	Especialmente diseñado para entornos empresariales que exigen rendimiento y confiabilidad. Ofrece la escala para ejecutar cargas de trabajo masivas, la eficiencia para controlar los costos operativos y la seguridad para proteger los datos cruciales, lo que lo convierte en un servidor fundamental para la innovación empresarial.	Densidad de almacenamiento y memoria del tamaño correcto	Rendimiento y valor mejorados	Densidad de rendimiento innovadora	Rendimiento innovador que escala	Diseñado para soportar cargas de trabajo densas de almacenamiento de datos
Cargas de trabajo objetivo	Virtualización, base de datos de escalamiento horizontal, big data y análisis, computación de alto rendimiento y computación de borde.	Virtualización de densidad media, bases de datos de escalamiento horizontal, big data y análisis, VDI, computación de alto rendimiento y almacenamiento definido por software.	Virtualización, aplicaciones nativas de la nube, SDS todo flash, cargas de trabajo de hiperescala y bases de datos de escalamiento horizontal	Virtualización, inferencia de inteligencia artificial, aplicaciones nativas en la nube, cargas de trabajo de hiperescala y bases de datos de escalamiento horizontal	Computación de alto rendimiento (HPC), virtualización de nivel superior y análisis intensivo de datos	Analítica de datos, virtualización densa y almacenamiento definido por software	Analítica de datos, virtualización densa y almacenamiento definido por software	Computación de alto rendimiento (HPC), infraestructura de escritorios virtuales (VDI) y virtualización	Computación de alto rendimiento (HPC), infraestructura de escritorios virtuales (VDI) y virtualización	Almacenamiento de objetos
Tipo de procesador	1 procesador Intel® Xeon® 6 E-core con hasta 144 núcleos o 1 procesador Intel® Xeon® 6 P-core con hasta 86 núcleos con opción R1S		2 procesadores Intel® Xeon® 6 E-core con hasta 144 núcleos o 2 procesadores Intel® Xeon® 6 P-core con hasta 86 núcleos		2 procesadores Intel® Xeon® 6 serie 6900 con núcleos P y hasta 128 núcleos		1 procesador AMD EPYC™ Serie 9005 de 5.ª generación; hasta 160 núcleos	2 procesador AMD EPYC™ Serie 9005 de 5.ª generación; hasta 192 núcleos		2 procesador AMD EPYC™ Serie 9005 de 5.ª generación; hasta 192 núcleos
Ranuras DIMM DDR5 (capacidad máxima)	16 (4 TB)	16 (4 TB)	32 (8 TB)		24 (3 TB)	24 (6 TB)	24 (6 TB)	24 (6 TB)	24 (6 TB)	24 (3 TB)
Unidades de disco hasta:	4 de 3,5" 8 de 2,5" 10 de 2,5" 8 E3.S/16 E3.S 2 x E3.S (parte posterior)	8 x 2,5 in 12 de 3,5" 16 de 2,5" 24 de 2,5" 8 E3.S/16 E3.S/32 E3.S 4 x E3.S (parte posterior)	8 de 2,5" 10 de 2,5" 8 E3.S/16 E3.S/20 E3.S 2 x E3.S (parte posterior)	8 de 2,5" 16 de 2,5" 24 de 2,5" 8 x E3.S/16 x E3.S (configuración FIO) 32 E3.S/40 E3.S 4 x E3.S (parte posterior)	8 de 2,5" 16 de 2,5" 32 E3.S	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 in/U.2 10 x 2,5 pulgadas 16 E3.S/20 E3.S 2 x E3.S (parte posterior)	2 U.2 8 x 2,5 in/U.2 12 x 3,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas 24 x 2,5 pulgadas 8 E3.S/16 E3.S/32 E3.S/40 E3.S	4 x 3,5 pulgadas 4 U.2 8 de 2,5" 10 de 2,5" 8 E3.S/16 E3.S/20 E3.S 2 x E3.S (parte posterior)	8 x 2,5 in/U.2 12 de 3,5" 16 x 2,5 pulgadas 24 x 2,5 pulgadas 8 E3.S/16 E3.S/32 E3.S/40 E3.S	24 de 2,5" U.2 Gen5
Unidades NVMe de hasta:	16	32	22	44	32	22	40	22	40	24
Ranuras PCIe de 5.ª generación hasta:	4	4	3	8	5	3	8	3	8	5*
Ranuras PCIe de 4.ª generación hasta:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Soporte de acelerador hasta:	4 x 75 W SW	3 x 400 W DW o 4 x 75 W SW	3 x 75 W SW	2 x 450 W DW o 6 x 75 W SW	N/A	3 x 75 W SW	3 x 450 W DW o 6 x 75 W SW	3 x 75 W SW	2 x 450 W DW o 6 x 75 W SW	N/A
Altura del rack (U)	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2
Seguridad integrada	Firmware firmado criptográficamente, cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa), arranque seguro, verificación segura de componentes (comprobación de integridad de hardware), raíz de confianza de silicio, borrado seguro, bloqueo del sistema (requiere iDRAC10 Enterprise o Datacenter), TPM 2.0 FIPS, certificación CC-TCG, detección de intrusión en el chasis					Firmware firmado criptográficamente, cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa), arranque seguro, verificación segura de componentes (comprobación de integridad de hardware), borrado seguro, raíz de confianza de silicio, bloqueo del sistema, TPM 2.0 FIPS, certificación CC-TCG, cifrado de memoria seguro (SME) de AMD, virtualización cifrada segura (SEV) de AMD, detección de intrusión en el chasis				

Nota: * Es posible que las características marcadas con un asterisco (*) no estén disponibles en el lanzamiento del producto. Consulte la página del configurador del producto en Dell.com para confirmar la disponibilidad de las características.

Servidores Dell PowerEdge en rack

Dell Technologies

Guía de referencia rápida

Servidor en rack	R760	R660	R7625	R6625	R7615	R6615	R660xs	R760xs	HS5610***	HS5620***
										
Atributos clave	Proporciona rendimiento y versatilidad para aplicaciones exigentes	Proporciona rendimiento y versatilidad para aplicaciones exigentes	Rendimiento innovador	Rendimiento innovador	Rendimiento y escalabilidad potentes	Rendimiento máximo y excelente TCO	Tamaño adecuado para las aplicaciones de TI más populares	Tamaño adecuado para las aplicaciones de TI más populares	Ecosistema abierto optimizado para cargas de trabajo de computación	Ecosistema abierto optimizado para cargas de trabajo densas de almacenamiento
Cargas de trabajo objetivo	Estandarización de cargas de trabajo mixtas, base de datos y analítica, infraestructura de escritorio virtual	Virtualización de alta densidad, análisis de base de datos densa, estandarización de cargas de trabajo mixtas	Computación de alto rendimiento (HPC), infraestructura de escritorios virtuales (VDI), virtualización	Computación de alto rendimiento (HPC), infraestructura de escritorios virtuales (VDI), virtualización	Almacenamiento definido por software (SDS), virtualización, análisis de datos	Virtualización, infraestructura hiperconvergente (HCI), virtualización de funciones de red (NFV)	Virtualización, nube, base de datos de escalamiento horizontal, recursos informáticos de alto rendimiento (HPC)	Virtualización, almacenamiento definido por software, densidad de VM media o VDI	Virtualización, base de datos de escalamiento horizontal, nodo de almacenamiento definido por software	Virtualización, densidad de VM media o VDI, nodo de almacenamiento definido por software
Tipo de procesador	2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª generación; hasta 56 núcleos por procesador, o 2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 5.ª generación; hasta 64 núcleos por procesador		2 procesadores AMD EPYC™ serie 9004 de 4.ª generación, hasta 128 núcleos por procesador		1 procesador AMD EPYC™ serie 9004 de 4.ª generación; hasta 128 núcleos		2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 5.ª generación con hasta 28 núcleos, o 2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª generación con hasta 32 núcleos por procesador		2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 5.ª generación con hasta 32 núcleos, o 2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª generación con hasta 32 núcleos por procesador	
Ranuras DIMM DDR5 (capacidad máxima)	32 (8 TB)		24 (6 TB)		12 (3 TB)		16 (1,5 TB)	16 (1,5 TB)	16 (2 TB)	16 (2 TB)
Unidades de disco hasta:	12 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas 24 x 2,5 pulgadas 16 E3.S 2 x 2,5" (parte posterior) 4 x 2,5" (parte posterior) 4 x E3.S (parte posterior)	8 x 2,5 pulgadas 10 x 2,5 pulgadas 10 x 2,5 pulgadas 14 E3.S 16 E3.S 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior) 2 x E3.S (parte posterior)	8 x 3,5 pulgadas 12 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas 24 x 2,5 pulgadas 2 x 2,5" (parte posterior) 4 x 2,5" (parte posterior) 4 x E3.S (parte posterior)	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 10 x 2,5 pulgadas 14 E3.S 16 E3.S 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior) 2 x E3.S (parte posterior)	8 x 3,5 pulgadas 12 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas 24 x 2,5 pulgadas 2 x 2,5" (parte posterior) 4 x 2,5" (parte posterior) 4 x E3.S (parte posterior)	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 10 x 2,5 pulgadas 14 E3.S 16 E3.S 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior) 2 x E3.S (parte posterior)	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 10 x 2,5 pulgadas 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior)	12 x 3,5 pulgadas 8 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas + 8 x NVMe 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior)	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 6 x NVMe 10 x 2,5 pulgadas 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior)	12 x 3,5 pulgadas 8 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas + 8 x NVMe 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior)
Unidades NVMe de hasta:	24	10	24	10	24	10	10	8	10	8
Ranuras PCIe de 5.ª generación hasta:	4	2	4	2	4	2	2	2	2	2
Ranuras PCIe de 4.ª generación hasta:	8	3	8	3	4	3	3	4	3	4
Soporte de acelerador hasta:	2 x 350 W DW o 6 x 75 W SW	3 x 75 W SW	2 x 300 W DW o 6 x 75 W SW	3 x 75 W SW	3 x 300 W DW o 6 x 75 W SW	3 x 75 W SW	N/A	2 x 75 W SW	N/A	2 x 75 W SW
Altura del rack (U)	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2
Seguridad integrada	TPM 2.0 FIPS, certificado por CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ, firmware firmado criptográficamente, alerta de intrusión en el chasis, seguridad estándar de arranque seguro, raíz de confianza de silicio, bloqueo de sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter), cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa), verificación de componentes seguros (verificación de integridad de hardware) y borrado del sistema en todos los racks.			TPM 2.0 FIPS, certificación CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ, firmware firmado criptográficamente, arranque seguro, borrado seguro, raíz de confianza de silicio, bloqueo de sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter), AMD Secure Memory Encryption (SME) y virtualización cifrada segura (SEV) de AMD			TPM 2.0 FIPS, certificado por CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ, firmware firmado criptográficamente, alerta de intrusión en el chasis, seguridad estándar de arranque seguro, raíz de confianza de silicio, bloqueo de sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter), cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa), verificación de componentes seguros (verificación de integridad de hardware) y borrado del sistema en todos los racks.			

Nota: * Es posible que las características marcadas con un asterisco (*) no estén disponibles en el lanzamiento del producto. Consulte la página del configurador del producto en Dell.com para confirmar la disponibilidad de las características.

*** Los servidores HS560 y HS5620 se ofrecen exclusivamente a través del programa Hyperscale Next para clientes seleccionados.

Servidor en rack	R960	R860	R760xa	R760xd2	R360	R260
						
Atributos clave	Aceleración extrema para la continuidad comercial y el escalamiento horizontal	Potencie las cargas de trabajo principales y críticas del negocio con computación de alta densidad	Servidor escalable de alto rendimiento para aplicaciones GPU intensivas	Almacenamiento denso, recuperación y escalabilidad más rápidas	Productividad optimizada, GPU empresarial de alto rendimiento y computación potente para abordar aplicaciones de negocio comunes.	Servidor en rack de poca profundidad con bisel filtrante para clientes cercanos al borde con los últimos procesadores Intel Xeon serie E-2400, memoria DDR5, BOSS NVMe y PSU Energy Star 4.0
Cargas de trabajo objetivo	Grandes bases de datos en la memoria, análisis de datos, IA y virtualización, infraestructura de escritorios virtuales (VDI)		Capacitación e inferencia de AI/ML/DL Gemelos digitales, gráficos de representación Gráficos de virtualización y VDI	Almacenamiento de archivos y objetos, captura de video y vigilancia, streaming de video	Colaboración y uso compartido, correo y mensajería, base de datos	Colaboración y uso compartido, correo y mensajería, aplicaciones cercanas al borde
Tipo de procesador	4 procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª generación con hasta 60 núcleos por procesador y con tecnología Intel® QuickAssist opcional		2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª generación; hasta 56 núcleos por procesador, o 2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 5.ª generación; hasta 64 núcleos por procesador	2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª generación; hasta 32 núcleos por procesador o 2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 5.ª generación; hasta 28 núcleos por procesador	1 procesador Intel® Xeon® serie E-2400 con hasta 8 núcleos, o 1 procesador Intel® Pentium con 2 núcleos, o 1 procesador Intel® Xeon® serie 6300 con hasta 8 núcleos	1 procesador Intel® Xeon® serie E-2400 con hasta 8 núcleos, o 1 procesador Intel® Pentium con 2 núcleos, o 1 procesador Intel® Xeon® serie 6300 con hasta 8 núcleos
Ranuras DIMM DDR5 (capacidad máxima)	64 (16 TB)		32 (8 TB)	16 (1,5 TB)	4 (128 GB)	4 (128 GB)
Unidades de disco hasta:	8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas 24 x 2,5 pulgadas 32 x 2,5 pulgadas 16 E3.S 8 x 2,5 pulgadas + 16 E3.S	8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas 24 x 2,5 pulgadas 8 E3.S 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior)	6 x 2,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 6 E3.S	12 x 3,5" (bahía frontal) + 12 x 3,5" (bahía intermedia) 2 x 2,5" o 4 x 2,5" o 4 x 3,5" o 4 E3.S (parte posterior)	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas	2 x 3,5 pulgadas 6 x 2,5 pulgadas
Unidades NVMe de hasta:	24	24	8	4	N/D	N/D
Ranuras PCIe de 5.ª generación hasta:	12	8	12	N/D	N/D	N/D
Ranuras PCIe de 4.ª generación hasta:	N/A	4	N/D	5	2	2
Soporte de acelerador hasta:	4 x 400 W DW	N/A	4 DW de 400 W o 12 SW de 75 W	2 x 75 W SW, 1 x 75 W SW + 1 x 150 W SW o 1 x 180 W DW	1 x 60 W SW	N/A
Altura del rack (U)	4	2	2	2	1	1
Seguridad integrada	TPM 2.0 FIPS, certificado por CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ, firmware firmado criptográficamente, alerta de intrusión en el chasis, seguridad estándar de arranque seguro, raíz de confianza de silicio, bloqueo de sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter), cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa), verificación de componentes seguros (verificación de integridad de hardware) y borrado del sistema en todos los racks.					

Servidores Dell PowerEdge en rack

Guía de referencia rápida

Servidor en rack	XE7745	XE7740	XE9680L	XE9685L
				
Atributos clave	Especialmente diseñadas para la inferencia de IA, el ajuste de modelos y la computación de alto rendimiento, las ranuras de GPU internas se combinan con ocho ranuras PCIe Gen 5.0 adicionales para la conectividad de red, lo que crea configuraciones densas y flexibles con el doble de capacidad de GPU PCIe DW en comparación con Dell PowerEdge R760xa	Especialmente diseñadas para la inferencia de IA, el ajuste de modelos y la computación de alto rendimiento, las ranuras de GPU internas se combinan con ocho ranuras PCIe Gen 5.0 adicionales para la conectividad de red, lo que crea configuraciones densas y flexibles con el doble de capacidad de GPU PCIe DW en comparación con Dell PowerEdge R760xa	Entrenamiento de IA y rendimiento de HPC inigualables con CPU y GPU refrigeradas con enfriamiento líquido directo en un factor de forma de 4U	Entrenamiento de IA y rendimiento de HPC inigualables con CPU y GPU refrigeradas con enfriamiento líquido directo en un factor de forma de 4U
Cargas de trabajo objetivo	Ajuste de IA generativa, inferencia de IA generativa, procesamiento del lenguaje natural, gemelos digitales e IA de agente	Ajuste de IA generativa, inferencia de IA generativa, procesamiento del lenguaje natural, gemelos digitales e IA de agente	Entrenamiento de IA, entrenamiento de LLM, ajuste e inferencia de LLM a gran escala	Entrenamiento de IA, entrenamiento de LLM, ajuste e inferencia de LLM a gran escala
Tipo de procesador	Dos procesadores AMD EPYC™ serie 9005 de 5.ª generación con hasta 192 núcleos por procesador	2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 5.ª generación; hasta 56 núcleos por procesador	2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 5.ª generación; hasta 64 núcleos por procesador	Dos procesadores AMD EPYC™ serie 9005 de 5.ª generación con hasta 192 núcleos por procesador
Ranuras DIMM DDR5 (capacidad máxima)	24 (3 TB)	24 (3 TB)	32 (4 TB)	24 (3 TB)
Unidades de disco hasta:	8 E3.S	8 E3.S	8 x 2,5 pulgadas	8 x 2,5 pulgadas
Unidades NVMe de hasta:	NA	N/A	8	8
Ranuras PCIe de 5.ª generación hasta:	8	8	12	12
Ranuras PCIe de 4.ª generación hasta:	N/A	N/A	N/A	N/A
Soporte de acelerador hasta:	8 x 600 W SW o 16 x 75 W SW	8 x 600 W SW o 16 x 75 W SW	8 GPU NVIDIA HGX B200 SXM6 de 180 GB y 1000 W, completamente interconectadas con tecnología NVIDIA NVLink	8 GPU NVIDIA HGX B200 SXM6 de 180 GB y 1000 W, completamente interconectadas con tecnología NVIDIA NVLink
Altura del rack (U)	4	4	4	4
Rack integrado	N/A	N/A	IR5000 requerido	IR5000 requerido
Seguridad integrada	Firmware firmado criptográficamente, cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa)*, arranque seguro, verificación segura de componentes (comprobación de integridad de hardware), borrado seguro, raíz de confianza de silicio, bloqueo del sistema (requiere iDRAC10 Enterprise o Datacenter)*, TPM 2.0 FIPS, certificación CC-TCG, cifrado de memoria seguro (SME) de AMD, virtualización cifrada segura (SEV) de AMD	Detección de intrusión en el chasis, firmware firmado criptográficamente, cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa)*, arranque seguro, verificación segura de componentes (comprobación de integridad de hardware), borrado seguro, raíz de confianza de silicio, bloqueo del sistema (requiere iDRAC10 Enterprise o Datacenter), TPM 2.0 FIPS, certificación CC-TCG	Firmware firmado criptográficamente, cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa), arranque seguro, verificación segura de componentes (comprobación de integridad de hardware), borrado seguro, raíz de confianza de silicio, bloqueo del sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter), TPM 2.0 FIPS, certificación CC-TCG	Firmware firmado criptográficamente, cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa), arranque seguro, verificación segura de componentes (comprobación de integridad de hardware), borrado seguro, raíz de confianza de silicio, bloqueo del sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter), TPM 2.0 FIPS, certificación CC-TCG

Nota: * Es posible que las características marcadas con un asterisco (*) no estén disponibles en el lanzamiento del producto. Consulte la página del configurador del producto en Dell.com para confirmar la disponibilidad de las características.

Servidor en rack	XE9680	XE9640	XE8640	XR7620	XR5610
					
Atributos clave	Rendimiento acelerado de entrenamiento de IA sin concesiones, flexibilidad para elegir GPU H100, 2 conectores de 6U con compatibilidad con una temperatura ambiente de hasta 35 °C	Rendimiento de IA y HPC con densidad optimizada, y CPU y GPU refrigeradas con enfriamiento líquido directo en un factor de forma de 2U	Capacitación de ML/DL más rápida y rendimiento de HPC, servidor de 2 conectores de 4U, ambiente de hasta 35 °C, profundidad de rack estándar	Servidor de 2 conectores de 2U de poca profundidad, alta capacidad y alto rendimiento optimizado para el borde	Alto rendimiento, poca profundidad, resistente, montaje inverso, bisel filtrado, temperaturas de funcionamiento de -5 °C a 55 °C
Cargas de trabajo objetivo	Capacitación de modelos grandes, procesamiento del lenguaje natural, motores de recomendación, IA conversacional, traducción, descubrimiento de fármacos	Modelado y simulación de HPC, análisis sísmico, dinámica de fluidos computacional, petróleo y gas, capacitación de IA/ML, detección de objetos, clasificación de imágenes	Modelado y simulación de HPC, análisis sísmico, dinámica de fluidos computacional, petróleo y gas, capacitación de IA/ML, detección de objetos, clasificación de imágenes	Automatización industrial, análisis de video, análisis de punto de venta, inferencia de IA, agregación de datos de recursos de borde y análisis	vRAN, D-RAN, O-RAN, automatización industrial, análisis de video, análisis de punto de venta, inferencia de IA, agregación y análisis de datos de recursos de borde
Tipo de procesador	2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª generación con hasta 56 núcleos por procesador, o 2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 5.ª generación con hasta 56 núcleos por procesador	2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª generación; hasta 56 núcleos por procesador, o 2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 5.ª generación; hasta 64 núcleos por procesador	2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª generación; hasta 56 núcleos por procesador, o 2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 5.ª generación; hasta 64 núcleos por procesador	2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 5.ª generación; hasta 16 núcleos por procesador, o 2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª generación; hasta 32 núcleos por procesador	1 procesador escalable Intel® Xeon® de 5.ª generación con hasta 16 núcleos por procesador o 1 procesador escalable Intel® Xeon® de 4.ª generación con hasta 32 núcleos por procesador
Ranuras DIMM DDR5 (capacidad máxima)	32 (4 TB)	• 16 GPU Intel (1 TB) • 8, 16 y 32 GPU NVIDIA (2 TB)	32 (4 TB)	16 (1 TB)	8 (1 TB)
Unidades de disco hasta:	8 x 2,5 pulgadas 16 E3.S	4 x 2,5 pulgadas	8 x 2,5 pulgadas	4 x 2,5 pulgadas 8 E3.S	4 x 2,5 pulgadas
Unidades NVMe de hasta:	8	4	8	4	4
Ranuras PCIe de 5.ª generación hasta:	10	4	4	2	2
Ranuras PCIe de 4.ª generación hasta:	N/A	N/A	N/A	5	N/D
Soporte de acelerador hasta:	8 GPU NVIDIA HGX H100 SXM5 de 80 GB y 700 W o GPU NVIDIA HGX H800 8-GPU SXM de 80 GB y 700 W, GPU NVIDIA HGX H200 8-GPU SXM de 141 GB y 700 W, GPU NVIDIA HGX H20 8-GPU SXM de 96 GB y 500 W u 8 GPU OAM AMD Instinct MI300X de 192 GB y 750 W u 8 GPU OAM Intel Gaudi3 de 128 GB y 900 W	4 GPU NVIDIA H100 SXM NVLINK de 7000 W o GPU Intel Data Center GPU Max Series 1550 OAM Xelink de 600 W	4 GPU NVIDIA HGX H100 SXM5 de 80 GB y 700 W, completamente interconectadas con tecnología NVIDIA NVLink	4 x 150 W SW o 2 x 300 W DW	2 x 75 W SW
Altura del rack (U)	6	2	4	2	1
Rack integrado	Opcional: IR5000	N/A	N/A	N/A	N/A
Seguridad integrada	TPM 2.0 FIPS, certificado por CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ, firmware firmado criptográficamente, alerta de intrusión en el chasis, seguridad estándar de arranque seguro, raíz de confianza de silicio, bloqueo de sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter), cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa), verificación de componentes seguros (verificación de integridad de hardware) y borrado del sistema en todos los racks.				

Nota: * Es posible que las características marcadas con un asterisco (*) no estén disponibles en el lanzamiento del producto. Consulte la página del configurador del producto en Dell.com para confirmar la disponibilidad de las características.

Servidor en rack	R750	R750xa	R650	R7525	R6525	R7515	R6515	R750xs	R650xs	R450	R550	XR11	XR12	R350	R250
Atributos clave	Rendimiento destacado para las cargas de trabajo más exigentes	Cargas de trabajo de GPU muy intensivas	Alta escalabilidad, rendimiento de carga de trabajo optimizada	Rendimiento poderoso y flexibilidad	Virtualización densa	Rendimiento y escalabilidad potentes	Procesamiento de alta densidad	Servidor 2U especialmente diseñado para crecientes soluciones de escalamiento horizontal	Servidor 1U de rendimiento completo y especialmente diseñado para soluciones de escalamiento horizontal densas y de rápido crecimiento	Valor y enfoque en densidad, TI diseñada para fines generales	Versátil, con optimización de valor, preparado para la virtualización, TI diseñada para fines generales.	Centrado en el perímetro, de poca profundidad y resistente con opciones montaje invertido	Centrado en el perímetro, de poca profundidad y resistente con opciones montaje invertido	Rendimiento potente en un servidor de 1U para aplicaciones con uso intensivo de datos y productividad	Procesamiento potente para aplicaciones de negocios comunes y optimización de la productividad
Cargas de trabajo objetivo	Bases de datos y análisis, HPC, ambientes corporativos tradicionales de TI, VDI, inteligencia artificial o ML	Capacitación o inferencia de IA, ML o DL, HPC y ambientes de virtualización	Estandarización de cargas de trabajo mixtas, base de datos y análisis, HFT, ambientes corporativos tradicionales de TI, VDI, HPC, inteligencia artificial o ML	Análisis de SDS, VDI y análisis de datos flash	HPC, VDI densa y virtualización	SDS, virtualización y análisis de datos	Virtualización, HCI y NFV	Virtualización, densidad de máquina virtual media o VDI y cargas de trabajo de bases de datos de escalamiento horizontal	Virtualización, nube, base de datos de escalamiento horizontal y cargas de trabajo de recursos informáticos de alto rendimiento	Infraestructura de TI pequeña, máquina virtual ligera, cargas de trabajo específicas para pequeñas empresas	Infraestructura de TI pequeña, densidad de máquina virtual ligera, cargas de trabajo específicas para pequeñas empresas	Telco/5G (MEC, CDN, vRAN), Ejército, Sector minorista (Análisis: videovigilancia/ POS/agrupación de IOT)	Telco/5G (MEC, CDN, vRAN), Ejército, Sector minorista (Análisis: videovigilancia/ POS/agrupación de IOT)	Pequeñas y medianas empresas, oficinas remotas/ sucursales, colaboración y uso compartido, análisis de datos y cargas de trabajo de virtualización	Pequeñas y medianas empresas, oficinas remotas/ sucursales, colaboración y uso compartido, correo/ mensajería y cargas de trabajo de archivos/ impresión
Tipo de procesador	2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 3.ª generación; hasta 40 núcleos por procesador			2 procesadores AMD EPYC™ de 2.ª o 3.ª generación; hasta 64 núcleos por procesador		1 procesador AMD EPYC™ de 2.ª o 3.ª generación; hasta 64 núcleos por procesador		2 procesador escalable Intel® Xeon® de 3.ª generación; hasta 32 núcleos por procesador		2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 3.ª generación; hasta 24 núcleos por procesador		1 procesador escalable Intel® Xeon® de 3.ª generación; hasta 36 núcleos por procesador		1 procesador Intel Xeon serie E-2300 con hasta 8 núcleos o 1 procesador Intel Pentium con hasta 2 núcleos	
Ranuras DIMM DDR4 (capacidad máxima)	32 (8 TB)		32 (4 TB)				16 (2 TB)		16 (1 TB)		8 (1 TB)		4 (128 GB)		
Unidades de disco hasta:	12 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas 24 x 2,5 pulgadas 2 x 2,5 pulgadas o 4 x 2,5 pulgadas (parte posterior)	6 x 2,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 10 x 2,5 pulgadas 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior)	12 x 3,5 pulgadas 26 x 2,5 pulgadas	4 x 3,5 pulgadas 12 x 2,5 pulgadas	12 x 3,5 pulgadas 24 x 2,5 pulgadas	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas	8 x 3,5 pulgadas 12 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 y 8 x 2,5"	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 10 x 2,5 pulgadas 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior)	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas	8 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas	4 x 2,5 pulgadas	6 x 2,5 pulgadas	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas	4 x 3,5 pulgadas 4 x 3,5 pulgadas (cableados) 2 x 3,5 pulgadas (cableados)
Unidades NVMe de hasta:	24	8	12	24	12	24	10	8	10	N/D		4	6	N/D	
Ranuras PCIe de 4.ª generación hasta:	8	8	3	8	3	2	1	5	3	2	3	3	5	3	2
Ranuras PCIe de 3.ª generación hasta:	N/A					2	1	1	N/D		1	N/D			
Soporte de acelerador hasta:	2 x 300 W DW o 4 x 150 W SW o 6 x 75 W SW	4 x 150 W SW o 4 x 300 W DW 2 x 75 W SW	3 x 75 W SW	3 x 300 W DW o 6 x 75 W SW	3 x SW	4 x SW; 1 x DW; 1 x FPGA	1 x SW	N/A				2 x 75 W SW	2 x 75 W o 150 W SW 2 x 300 W DW	N/A	
Altura del rack (U)	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1
Seguridad integrada	TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG certificada, TPM 2.0 China NationZ, firmware firmado criptográficamente, alerta de intrusión en el chasis y arranque seguro como seguridad estándar en todos los racks. Características de seguridad integrada, como Silicon Root of Trust, Bloqueo del sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter) y el borrado del sistema en todos los racks														

Servidores Dell PowerEdge en rack

Dell Technologies

Guía de referencia rápida

Servidor en rack	R940	R940xa	R840	R740xd	R740	R740xd2	R640	R540	R440	R340	R240
											
Atributos clave	Rendimiento potente	Aceleración extrema	Análisis de datos optimizada	Rendimiento de almacenamiento ampliable	Óptimo rendimiento de las aplicaciones	Servidor de contenido empresarial	Rendimiento y densidad	Balanceado y adaptable	Computación de escalamiento horizontal	Acelere el crecimiento del negocio	Procesamiento simplificado
Cargas de trabajo objetivo	Bases de datos en la memoria	Aceleración de la base de datos con GPU y aprendizaje automático	Cargas de trabajo con uso intensivo de datos, HFT y virtualización densa	SDS, proveedores de servicios y servidores de big data	Cargas de trabajo de VDI y en la nube	Streaming de medios y SDS	Almacenamiento y computación de centro de datos de escalamiento horizontal denso	Mensajería y virtualización de correo	Infraestructura de HPC, Web Tech y escalamiento horizontal	Aplicaciones con uso intensivo de datos y productividad de ROBO	Pequeñas empresas y cargas de trabajo del proveedor de servicios
Tipo de procesador	4 procesadores Intel® Xeon® de 2.ª generación escalables			2 procesadores Intel® Xeon® de 2.ª generación escalables						1 procesador Intel Xeon E-2200, Intel Core i3®, Intel Pentium® o Intel Celeron®	
Ranuras DIMM DDR4 (capacidad máxima)	48 (15,36 TB)			24 (7,68 TB)		16 (1 TB)	24 (7,68 TB)	16 (1 TB)		4 (64 GB)	
Unidades de disco hasta:	24 x 2,5 pulgadas	32 x 2,5 pulgadas	26 x 2,5 pulgadas	18 x 3,5 pulgadas 32 x 2,5 pulgadas	8 x 3,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas	26 x 3,5 pulgadas 16 x 3,5" + 10 x 2,5 pulgadas ²	4 x 3,5 pulgadas 12 x 2,5 pulgadas	14 x 3,5 pulgadas	4 x 3,5 pulgadas 10 x 2,5 pulgadas	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas	4 x 3,5 pulgadas 4 x 2,5 pulgadas ²
Unidades NVMe de hasta:	12	4	24	N/D		10	N/D	4	N/D		
Ranuras PCIe de 4.ª generación hasta:	N/A										
Ranuras PCIe de 3.ª generación hasta:	13	12	6	8	5	3	5	2	2		
Soporte de acelerador hasta:	N/A	4 x GPU DW o 4 x DW u 8 x FPGA de SW	2 x GPU de DW o 2 x SW o FPGA de DW	3 GPU de DW o 6 GPU de SW, o 3 FPGA de DW o 4 FPGA de SW		N/A	1 x GPU de SW o 1 x FPGA de SW	N/A			
Altura del rack (U)	3	4	2				1	2	1	1	
Seguridad integrada	TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG certificada, TPM 2,0 China NationZ, firmware firmado criptográficamente, alerta de intrusión en el chasis y arranque seguro como seguridad estándar en todos los racks. Características de seguridad integrada, como Silicon Root of Trust, Bloqueo del sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter) y el borrado del sistema en todos los racks										

¹ No todas las funciones están disponibles en todas las plataformas.

² Las unidades utilizan portauidades híbrido para encajar en la bahía de unidades de 3,5 pulgadas. (Para R740xd2: hay una configuración híbrida disponible con hasta 10 SSD de 2,5 pulgadas)

Arquitectura con resiliencia cibernética para operaciones y entorno de TI de confianza cero

La seguridad está integrada en todas las fases del ciclo de vida útil de PowerEdge, lo cual incluye una cadena de suministro protegida y la garantía de integridad de fábrica al sitio. La raíz de la confianza basada en silicio afianza la resiliencia de arranque integral, mientras que la autenticación de múltiples factores (MFA) y los controles de acceso basado en funciones protegen las operaciones de confianza.

Sustentabilidad

Desde materiales reciclados en nuestros productos y embalaje hasta opciones cuidadosas e innovadoras para la eficiencia energética, el portafolio de PowerEdge está diseñado para fabricar, entregar y reciclar productos a fin de ayudar a reducir la huella de carbono y reducir los costos operativos. Incluso facilitamos el retiro responsable de los sistemas heredados con Dell Technologies.

Aumente la eficiencia y acelere las operaciones con una infraestructura autónoma

El portafolio de Dell OpenManage Systems Management domina la complejidad de la administración y la protección de la infraestructura de TI. Con las herramientas intuitivas integrales de Dell Technologies, la TI puede brindar una experiencia segura e integrada al reducir los silos de información y procesos para concentrarse en hacer crecer el negocio. El portafolio de Dell OpenManage es la clave para su motor de innovación, ya que desbloquea las herramientas y la automatización que lo ayudan a escalar, administrar y proteger su entorno tecnológico.

Descanse tranquilo con Dell Technologies Services

Maximice sus servidores PowerEdge con servicios integrales diseñados para satisfacer sus necesidades dondequiera que se encuentre. Acelere el tiempo de creación de valor para lograr casos de uso elevados de IA con [servicios profesionales para IA](#), elija entre opciones de implementación personalizadas con [ProDeploy Suite](#), reciba soporte proactivo y predictivo con [ProSupport Suite](#), y mucho más con nuestros servicios disponibles en 170 ubicaciones y respaldados por nuestros más de 60 000 empleados y partners.

Descubra más sobre los servidores PowerEdge



Más información
acerca de los servicios
para servidores de
PowerEdge



Más información acerca
de nuestras soluciones
de administración de
sistemas



Buscar en nuestra
biblioteca de
recursos



Siga los servidores
PowerEdge en X
(anteriormente
Twitter)



Póngase en contacto
con un experto de Dell
Technologies para
[Ventas o soporte](#)



Siga servidores
de PowerEdge en
LinkedIn

Para obtener una lista completa, consulte en www.dell.com/PowerEdge. La disponibilidad de los productos puede variar según la región. Comuníquese con sus representantes de Dell para obtener más información.

Copyright © 2026 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus subsidiarias. Las demás marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios.